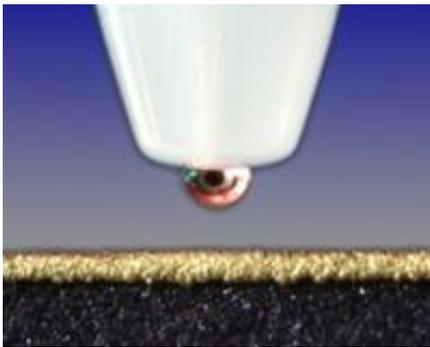


## TPT-Applikation 33 $\mu$ m Kupfer bonden

### Material:

- 33 $\mu$ m Kupfer Draht, 100m auf 2"Spule
- 33 $\mu$ m Kupfer Kapillare und Standard 33 $\mu$ m Wedge
- Halbautomatischer Drahtbonder HB16



Kapillare



Ball-Bond



Wedge-Bond

### Bondprozess Ball bonden:

- Wären der Ball-Formung (EFO) wird Forminggas (95%N<sup>2</sup>/5%H<sup>2</sup>) benötigt. Dieses kann geregelt werden mit TPT Kupfer Kit Option H47.
- Es wird empfohlen die Oberfläche des Substrats auf 120°C zu heizen.
- Es wird mehr Bond Druck als bei Gold Draht benötigt.

### Bondprozess Wedge bonden:

- Gleiches Verfahren wie Gold Wedge-Wedge bonden.
- Es wird empfohlen die Oberfläche des Substrats auf 120°C zu heizen.
- Es wird mehr Bond Druck als bei Gold Draht benötigt.

### Vorteile gegenüber Gold Bonden:

- Günstigerer Draht Preis (bei großen Serien-Produktionen)
- Bessere Elektrische Leitfähigkeit.
- Bessere Wärmeleitfähigkeit

